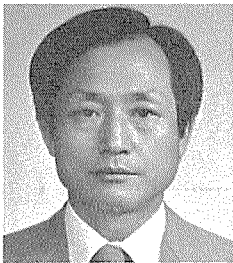


電子部品·材料 産業의 育成을 위한 政策 方向



金 光 植
商工部 電子部品課長

현재 우리 경제는 국내외적으로 여러가지 어려운 여건에 직면해 있다. 그러나 이러한 어려운 여건은 우리의 대응여하에 따라서는 우리나라가 선진산업사회로의 진입을 한걸음 앞당길 수 있는 좋은 기회를 제공할 수도 있다는 점을 인식할 필요가 있다.

1. 머리말

우리나라는 금년으로 전자산업 탄생 30주년을 맞는다. 1959년 처음으로 라디오를 조립 생산한 이래 우리나라의 전자산업은 비약적인 발전을 거듭하여 '87년도에 수출 100억불을 달성하였고 작년에는 섬유산업을 제치고 제1위의 수출산업으로 성장하여 우리나라의 수출선도산업으로 부상하였다.

그러나 전자산업도 타산업과 마찬가지로 여러가지 구조적인 문제점이 현실로 나타나고 있다. 선진국이 수백년간에 걸쳐 이룩한 경제성장의 성과를 최단시일내에 달성하고자 추진된 경제개발 5개년계획은 양질의 근면한 노동력은 풍부하나 자원, 자본, 기술이 부족한 상황에서 비교적 접근이 용이한 기기의 조립가공형 성장 전략을 채택하지 않을 수 없었고 이는 필연적으로 소재·부품산업과 기기산업과의 연관성의 결여로 부문간 균형적 성장에 장애요인이 되고 있다.

더구나 '80년대에 들어와 저임을 바탕으로한 후발개도국의 추격과 선진국의 신보호주의 및 시장개방압력 그리고 대내적으로 임금과 원화 가치의 상승 등 우리나라의 전자산업은 대내외적인 어려움에 직면하고 있다.

따라서 우리나라 전자산업이 치열한 국제경쟁하에서 앞으로도 지속적인 성장을 도모하기 위하여는 기초가 되는 부품·소재산업의 육성이 그 전제가 되어야 하고 그 육성은 기술개발을 통한 신제품 개발과 품질고급화에 그 중점이 두어져야 할 것이다.

이하에서는 이와 같은 관점에서 우리나라 전자부품·소재산업의 현황을 개관하고 정책방향을 검토해 보고자 한다.

2. 전자부품·재료산업의 현황



우리나라의 전자재료산업은 자금면에서 극히 취약한 구조를 가지고 있다.

가. 전자재료산업

전자재료는 부품과 최종제품인 기기의 특성을 좌우하는 기간산업적 위치에 있으며 이러한 특성은 신전자재료의 등장과 더불어 특히 강조되고 있다.

그러나 우리나라의 전자재료산업은 전자산업 중에서도 가장 취약한 구조를 가지고 있다. 그 이유는 우리나라의 전자산업발전이 소재·부품의 수입→조립가공→수출의 형태를 취하여 온데다가 재료의 경우 위험부담이 큰 장치산업이고 타산업에 비해 기술 발전속도가 빨라 계속적인 기술개발투자가 필요한 반면 국내수요가 대부분 다품종 소량이고 이 분야에 대한 정부의 정책의지가 상대적으로 미약한 점 등 기업의 투자 환경이 조성되지 못하였기 때문이다.

(1) 시장 동향

전자재료는 전세계적으로 미국과 일본이 70~80%를 점유하고 있으며 미국은 주로 소재분야에서, 일본은 이를 1차이상 가공한 전자재료분야에서 비교우위를 유지하고 있다. 일본의 전자재료 시장을 보면 최근 신소재와 이를 이용한 전자재료 개발이 활발히 추진되고 있어 '85년의 마이너스 성장에서 벗어나 급속한 성장을 보이고 있는바, 서기 2000년경에는 10조엔 규모('87 대비 광학재료 : 31배, 초전도체료 : 410배 신장 전망)의 시장이 형성될 것으로 보인다.

표 1 일본의 전자재료 시장 규모

(단위 : 10억엔)

구 분	'83	'85	'87	'89(추정)	2000(추정)
금 액	282.8	338.8	365.4	410.0	10,000.0
증가율 (%)	-	-6.9	5.2	6.8	-

자료 : 일본전자재료공업회

우리나라의 경우 전자제품의 생산증가에 따라 그 수요는 연평균 24.2%의 고도 성장을 하고 있으나 아직도 대부분 수입에 의존하고 있으며, 중소기업이 대부분(80%)을 점유하고 있어 미·일 등 선진국이 대부분 대기업에 의해 주도되고 있는 것과 큰 대조를 이루고 있다.

표 2 우리나라 전자재료산업의 수급 현황

(단위 : 백만불)

구 분	'81	'83	'85	'86	'86/'81	
수 요	내 수	616.8	940.3	1,219.8	1,822.8	24.2
	수 출	19.5	37.1	66.6	108.8	40.9
	계	636.3	977.4	1,286.4	1,931.6	24.9
공 급	생 산	108.1	145.3	328.7	722.8	46.2
	수 입	528.2	832.1	957.7	1,208.8	18.2
수입의존도 (%)	83.0	85.1	74.1	62.6	-	

자료 : KIET

(2) 기술 동향

'80년대 들어 세계 전자재료 산업계 특징 중의 하나는 「재료를 제패하는 국가가 시스템을

제패한다」는 인식하에 미·일 등 선진국간에 기술개발 경쟁이 격화되는 한편 상호보완적 협력이 활발히 이루어지고 있다는 점이다.

한편 미·일 등은 화인 세라믹스, 광전자재료 등 신전자재료분야에 연구개발력을 집중하는 반면, 기존재료분야에서는 후진국과의 협력을 모색하려는 움직임을 보이고 있다.

우리나라의 경우 독자적인 기술개발이 미미하여 도입기술에 의존하는 경우가 많았으나 최근에 이르러 정부출연연구소와 기업부설연구소, 대학연구소를 중심으로 신금속재료, 화인 세라믹스, 고분자재료, 신반도체재료, 복합재료 등 전자관련소재의 연구개발과 실용화에 많은 노력이 경주되고 있다.

나. 전자부품산업

(1) 세계시장 동향

세계 전자부품 시장은 산업용 전자기기 신장에 힘입어 확실한 성장을 보이고 있으며 반도체, 칩 부품 등을 중심으로 고도성장을 지속할 것으로 보인다.

표 3 분야별 세계 전자시장 동향 (단위: 억불)

구 분	'85	'88	'92
세계전자시장	3,727(100)	4,917(100)	6,507(100)
산업용기기	2,439(65)	3,232(66)	4,266(66)
가정용기기	418(11)	527(11)	645(10)
전자부품	870(24)	1,158(23)	1,596(24)

자료: EIAK

지역별로는 '87년 현재 미국이 전세계시장의 37%로서 압도적인 점유율을 보이고 있으나 점차 그 상대적 지위가 저하되는 반면 일본의 신

표 4 전자부품의 지역별 구조 (단위: 백만불, %)

구 분	'83	'87	'91	'83~'87	'87~'92
세계시장	74,211 (100)	108,192 (100)	136,950 (100)	9.9	6.1
미 국	30,691 (41.4)	40,018 (37.0)	50,136 (36.6)	6.9	5.8
일 본	16,706 (22.5)	27,168 (25.1)	35,847 (26.2)	12.9	7.2
유 럽	16,485 (22.2)	25,840 (23.9)	31,738 (23.2)	11.9	5.3
NICS	5,725 (7.7)	9,316 (8.6)	11,368 (8.3)	12.9	5.1
기 타	4,604 (6.2)	5,850 (5.4)	7,861 (5.7)	6.2	7.7

자료: Mackintosh Yearbook W. European '88

장세가 두드러지고 있어 앞으로 세계 전자부품 시장의 판도가 크게 변화될 것으로 예상된다.

(2) 우리나라의 시장 동향

- 시장규모

우리나라의 전자부품산업을 보면 '70년대까지는 전자기기 산업의 발달이 부진하였기 때문에 전자부품의 생산이 상대적으로 높았으나 '80년대 들어 가전, 정보기기 등의 급속한 성장으로 그 비중이 상대적으로 감소하고 있다.

앞으로도 반도체 등의 급속한 성장이 예상되기는 하나 비교적 정밀도가 낮은 범용부품의 경우 후발개도국들의 추격으로 경쟁력이 약화될 것이 예상되어 산업용 고정밀 부품 개발, 고밀도 실장기술 개발, 자동화 등에 주력하여야 할 것이기 때문에 물량면에서의 증가율은 상대적으로 둔화될 것으로 보인다.

- 수급구조

우리나라 전자부품산업의 수급구조를 보면 생

표 5 전자부품산업의 상대적 비중 추이

(단위: 백만불)

구 분	'70		'75		'80		'85		'88	
	생산액	구성비	생산액	구성비	생산액	구성비	생산액	구성비	생산액	구성비
전 자 산 업	106	100	860	100	2,852	100	7,285	100	23,531	100
산 업 용 제 품	17	16	94	11	364	13	1,518	21	4,573	19
가 정 용 제 품	30	28	270	31	1,148	40	2,411	33	9,211	39
전 자 부 품	59	56	496	58	1,340	47	3,356	44	9,747	42

자료: EIAK

산제품의 대부분을 수출(60%)하고 필요부품의 대부분을 수입(58%)하고 있다는 점이다. 이는 우리나라의 전자부품산업이 주로 미·일 등의 기술도입에 의존하고 있고 생산품목이 다양하지 못하여 필요부품을 수입하고 수출은 일부 범용 부품과 반도체를 중심으로 이루어지기 때문이다. 수입의 지역별 분포는 일본, 미국이 대부분을 점유하고 있으며 특히 대일지역에 지나치게 편중된 취약한 구조를 가지고 있다.

표 6 우리나라 전자부품산업의 수급구조 추이 (단위: 백만불)

구 분		'82	'84	'86	'88
공 급	생 산	1,818	3,531	5,164	9,747
	수 입	1,231	2,097	3,140	5,344
	계	3,049	5,628	8,304	15,091
수 요	내 수	1,970	3,490	5,315	9,241
	수 출	1,079	2,129	2,989	5,850
수출비율 (%)		59.4	60.3	57.9	60.0
수입의존도 (%)		62.5	59.9	59.1	57.8

자료: EIAK 통계에 의거 작성

표 7 국내부품산업의 수입의존도 (단위: %)

구 분	일 본	미 국	기 타	계
'86	60.9	23.5	15.6	100.0
'87	59.1	21.5	19.4	100.0
'88	57.4	24.2	18.4	100.0

자료: 무역통계에 의거 작성

한편 수출은 전자분야 총생산액의 60%, 총수출액의 38.6%를 수출에 의존('88기준)하고 있으며 미국에의 의존도가 높아 수출시장의 다변화가 절실히 요청되고 있다.

표 8 수출시장 구조

구 분	미 국	일 본	E C	홍 콩	기 타
'88	31.5	18.2	12.3	12.6	25.4
'89.5. 말	33.5	15.3	13.4	11.5	26.3

자료: 상공부

(3) 기술 동향

전자제품의 기술추세는 완제품의 경박단소화,

고기능화, 다기능화 추세에 따라 소형, 고밀도화(고집적화), 고성능화 추세로 이행되고 있다. 일반전자부품의 가장 핵심적인 기술추세는 기존의 부품에 리드선을 없애거나 극소화하여 PCB에 부착시킬 수 있게 하는 칩화이며, 칩부품을 기판에 장착시키는 SMT 기술이 발전하는 한편 디스플레이 분야에서는 액정, LED, LC, 프리즈마 등 기술이 발전하고 있다.

우리나라의 경우 조립기술과 일부 제품개발 기술은 선진국에 근접하고 있으나 전반적으로 크게 낙후되어 있어 기술개발을 위한 정부 및 산·학·연의 공동노력이 절실한 실정에 있다.

- 일반전자부품

- 제품개발: 가정용기기 위주에서 산업용기기의 부품개발 추진
- 공정기술: 조립기술 발달, 소재기술은 대부분 수입 의존

- 반 도 체

- 제품개발: '89. 3, 4 M DRAM 개발, '89. 4 ~ '93. 3, 16/64M DRAM 개발 등 기억소자분야는 선진국 접근, 논리소자, ASIC 등 여타 분야 취약
- 공정기술: 패키징 기술, 일부 공정기술을 제외한 설계, 재료, 장비기술은 선진국 대비 크게 낙후됨.

3. 우리나라 전자부품·소재산업의 당면 과제

이상의 설명을 통하여 우리나라 전자부품, 소재산업의 문제점과 당면과제가 어느 정도 부각되었으나 이를 다시 요약, 정리하면 다음과 같다.

가. 핵심기술의 취약

종전까지의 조립가공위주의 성장전략에 따라 조립기술은 선진국 수준에 이르렀으나 설계기술, 소재개발기술, 정밀가공기술, 테스트 기술 등 핵심기술과 금형, 화공 등 주변기술이 매우 취약한 상태에 있다.

이러한 상황에서 미·일 등 선진국은 상호협

력과 경쟁이라는 상반된 정책을 추구하면서 핵심기술을 과점, 개도국에 대한 핵심기술이전을 기피하는 한편 후발개도국은 중·저급 기술에서 우리나라를 급속히 추격하고 있으므로 이에 대한 대응책이 강구되어야 할 것이다.

나. 부품 및 재료산업의 생산기반 취약

중저급과 범용부품은 그간 가격경쟁력을 배경으로 어느 정도 그 기반을 형성하여 왔으나 부품 및 재료수입에 의한 기구조립가공 산업구조의 당연한 결과로서 고급품의 경우 대부분 수입에 의존함으로써 부품산업 자체의 성장은 물론 기기산업의 국제 경쟁력을 약화시키는 요인이 되고 있다.

특히 재료산업의 경우 일부 대기업을 제외한 대부분이 중소기업을 중심으로 성장하여 왔으며 대외수입의존도는 재료분야에 있어 특히 두드러져 그 생산기반이 전자산업 중 가장 취약한 상태에 있다. 전자재료의 경우 선진국이 기존 재료분야에서 후발국과의 협력 내지 이전을 추진하고 있는데 비추어 우선적으로 이들과의 합작을 통한 내수공급(Local 포함)에 중점을 두어야 하고 이와 병행하여 연구소 등을 중심으로 개발된 신개발기술의 기업화 촉진대책도 강구되어야 할 것이다.

다. 세트 업체와 부품업체간 상호연계성 미비

부품업체가 아무리 품질이 우수한 제품을 개발하였다 하더라도 세트 업체가 이를 사용하지 않으면 개발의 의미가 반감된다 하겠다.

실제 문제로서 계열화 관계가 성립되어 있는 경우에도 세트 업체와 부품업체의 수직적 종속에 의한 일방적 불평등관계 유지와 제품개발 단계에서의 자금, 기술지원 미비 등으로 부품업체와 세트 업체간 상호불신을 초래, 부품산업의 성장을 저해하는 요인이 되고 있다.

라. 대일 수입의존도의 심화

우리나라의 전자산업은 주로 일본으로부터의 기술도입에 의존하였고, 더구나 이에 관련한 자

본재 및 부품의 일괄도입을 통하여 기기제품을 생산한 후 주로 미국에 수출하는 형태를 취하여 왔기 때문에 전자제품의 수출증대는 부품, 소재의 수입유발을 촉진시켜 극심한 대일 무역역조를 초래하는 한편 수출의 대미편중으로 대미 무역마찰의 한 요인이 되고 있다.

물론 '86년부터 추진된 부품, 소재국산화 시책에 의거, 대일 수입증가율은 둔화되고 있으나 절대액은 아직도 계속 증가하고 있어 보다 적극적인 부품, 소재국산화의 추진이 요망되고 있다.

마. 반도체 산업의 심한 불균형

우리나라 반도체 산업은 기억소자분야에서는 4M DRAM 개발, 16/64M DRAM 공동연구 등으로 선진국 수준에 진입하고 있으나 앞으로 '90년대의 주력산업으로 부상하고 있는 주문형 반도체와 반도체장비 등 주변장치분야는 특히 취약한 상태에 있다.

따라서 반도체 산업의 균형적인 발전은 물론 이를 사용하는 기기산업의 대외경쟁력 유지를 위해서도 이 분야에 대한 집중적인 육성이 필요하다 하겠다.

4. 전자부품·재료산업의 육성시책 방향

가. 기능별 지원시책 방향

(1) 기술개발의 지속적 추진 지원

〈부품, 소재국산화 5개년계획의 지속적 추진과 보강〉

○개요 및 추진 실적

정부는 기계류, 부품, 소재의 국산화가 해당산업은 물론 이를 사용하는 기기산업의 국제경쟁력을 강화시키는 첩경임을 감안, '86년부터 석유사업안정기금 중 일부를 산업기술향상자금으로 전용, 대일수입 비중이 큰 품목을 중심으로 부품과 소재의 국산화를 추진하였고 '87년도부터는 「기계류, 부품, 소재국산화 5개년계획」을 수립하여 부품의 자금률을 '90년대에 70%까지 끌어올린다는 목표아래 부품, 소재국산화 시책을 추진한 결과 '88말 현재 35.7억불의 수입대체와 18.2억불의 수출증대효과(기계류, 부품, 소

재 포함)를 거양하였다.

○제도 운영상의 문제점 보완

부품, 소재국산화는 전술한 산업기술향상자금(용자)과 공업발전법에 의한 지원(출연, 용자→기반기술개발지원)이 있는바, 연간 지원규모에 비해 지원대상 과제가 많아 실제로 필요한 금액을 지원하는데 제약이 있었고 개발기술의 사업화 지원도 「수출산업설비금융」 자문에 불과하고 금리도 높아(11%/년) 실질적 지원이 미흡한 면이 없지 않았다.

따라서 정부는 금번에 중소기업의 경영안정 및 구조조정에 관한 특별조치법(제16조)에 근거한 중소기업기술개발자금을 조성, 중소기업에 대한 기술개발자금(부품·소재 포함)을 '89~'94까지 총 3,100억원을 지원할 예정이며 개발기술의 사업화 자금도 연리 9%의 저리자금을 지원할 계획으로 있다.

한편 공업발전기금(용자)과 공업기반기술개발사업자금(출연금)은 중견기업과 첨단기술 산업분야에 중점 지원할 예정으로 있다.

기타 제도운영상 문제점으로 대두되고 있는 연구조합의 공동입보문제(신용보증시)와 연구조합의 비합리적인 구분(대기업형과 중소기업형으로 분리, 차등지원) 문제 등도 점차 개선해나갈 계획으로 있다.

〈첨단산업발전 5개년계획의 수립 추진〉

정부는 '88. 9. 첨단산업발전 없이는 전통산업의 발전도 기대할 수 없다는 인식하에 첨단산업발전심의회를 구성(위원장: 상공부 차관) 하고 산하에 학계, 연구소, 업계 전문가로 구성된 6개 분과위원회 [ME산업, 메카트로닉 산업, 광산업(신규 추가), 신소재산업, 정밀화학산업, 생물산업, 항공기산업]를 두어 여러 차례에 걸친 연구검토와 공청회를 거쳐 각계의 의견을 수렴한 바 있으며 곧 연구보고서가 정부에 제출될 것으로 보인다.

한편 동연구보고서에서 건의된 내용을 구체적으로 뒷받침, 집행하기 위하여 가칭 「첨단산업발전기반 조성을 위한 임시조치법(안)」을 마련중에 있어 이를 통하여 향후 우리나라의 반도체 신소재 등 첨단기술산업의 획기적 발전이 기

대되고 있다.

(2) 기술인력 개발지원

기술개발은 결국 인간의 두뇌가 해내는 일이기 때문에 기술인력개발은 기술개발 중에서도 가장 중요한 핵심적 요소가 된다.

1955년 영국의 이공계 : 인문계 대학의 인력 구성비가 1 : 1 이었던데 비하여 일본의 경우 10 : 1 이었다는 사실은 일본과 구미선진국의 오늘을 설명하는데 많은 시사점을 준다 하겠다.

전술한 첨단산업발전 5개년계획에서도 기술인력 개발에 큰 비중을 두고 있는바, 앞으로 기술계 인력확보를 위한 구체적인 후속조치가 취해질 것으로 예상되고 있다.

한편 이와는 별도로 중소기업의 만성적인 기술인력 부족상태를 개선하기 위하여 중소기업에 대한 정부의 인력양성 수요계획에 따라 연구기관 등에 위탁교육을 의뢰하는 중소기업에 직접 지원하는 방안을 검토중에 있다.

(3) 개발제품의 판로 확보 지원

제품의 개발초기에는 그 신뢰성 때문에 기업체가 사용을 기피하는 사례가 있는바 수요자가 마음놓고 사용할 수 있는 분위기 조성이 필요하다. 따라서 우선 제품개발 단계에서 수급협의회 구성, 확대 등을 통한 협동개발을 유도하고 기계연구소 등을 통한 외국규격 획득지원과 새로 탄생할 생산기술연구원을 통한 시험·검사기능을 강화하여 제품의 신뢰성 제고에 노력할 것이다.

아울러 기술개발촉진법상의 신기술보호제도는 한·미통상 협상결과에 따라 폐지될 예정이나 중소기업의 경우 공공기관에 의한 우선구매제도 도입을 적극 검토하고 있다.

(4) 투자의 활성화 지원

'89년 전자부품산업의 투자전망을 보면 반도체에 1조 3,000억원('88 : 5,914억원) 일반전자부품에 7,500억원('88 : 2,559억원) 계 2조 500억원('88 : 9,474억원)에 달할 것이 예상되고 있다. 정부는 이러한 투자를 뒷받침하기 위하여 금융세계 면의 지원시책을 강구하고 있다. '89년도 중 시설제에 대한 특별외화대출 50억원을 책정한 바 있으나 필요할 경우 추가지원도

고려하고 있다.

아울러 특정기계설비에 대한 내용연수를 단축하고 시설재 도입설비에 대한 관세감면도 향후 3년간 연장하기로 한 바 있다.

임시 투자세액 공제제도는 '90. 6월말로 만료될 예정으로 있으나 최근 노사분규, 원화절상 등으로 기업의 투자 마인드가 저상되어 있는 점을 감안, 이의 연장 문제도 신중히 검토할 계획으로 있다.

나. 분야별 지원시책 방향

(1) 반도체 산업

기억소자분야에 있어서는 4M DRAM의 산·학·연 공동개발지원한데 이어 '89. 4~'93. 3기간 중 16/64M DRAM의 공동개발을 지원키로 하고 이미 동개발이 추진중에 있다. ASIC 분야는 우리나라가 미·일 등은 물론 경쟁대상국인 대만의 수준에도 미치지 못하고 있다.

ASIC 산업은 동산업 자체 뿐 아니라 점차 경쟁력이 떨어지는 가전기기의 경쟁력 향상은 물론 컴퓨터 등 정보기기와 앞으로 미·일·EC 등이 개발을 서두르고 있는 HDTV의 핵심부품으로서 그 중요성이 증대되고 있기 때문에 최근 대기업을 중심으로 하여 활발히 연구개발이 진행되고 있으나 가장 큰 문제가 전문인력이 부족하다는 점이다.

따라서 기존의 서울대 반도체공동연구소 외에 연세대학교에 ASIC 전문인력양성센터를 설치하여 특히 중소기업이 필요로 하는 전문설계인력을 양성, 공급하는 방안을 검토중에 있다.

한편 장비분야는 기억소자를 중심으로 활발한 투자가 이루어지고 있어 그 수요가 방대('89 예상 : 1조 3,000억원)하나 대부분을 수입에 의존하고 있으므로 앞으로 5년후에는 국산화율을 50%로 끌어 올린다는 목표아래 현재 반도체장비 국산화 5개년계획을 마련중에 있다.

(2) 전자재료산업

우리나라의 전자재료산업은 대부분 중소기업

이 영위하고 있어 인력, 자금면에서 극히 취약한 구조를 가지고 있다. 따라서 소재분야의 기술개발은 우선 상업성이 큰 제품을 중심으로 기업간 공동개발 특히 대학 및 KIST 등 전문연구소 등과의 공동개발을 적극 유도하고 아울러 기초소재와 재료의 재질 및 세부특성에 대한 시험기준의 표준화 작업과 소재·재료 평가센터의 설립 추진을 검토중에 있다.

또한 전자재료연구조합을 중심으로 한 장기과제로서 원료의 배합, 합성기술, 성형기술, 소성기술, 측정 및 검사기술과 Fine Ceramics, 고분자재료 등 첨단소재의 연구개발을 KAIST 및 대학연구소 등과 공동으로 추진할 계획으로 있다.

5. 맺음말

현재 우리 경제는 국내외적으로 여러가지 어려운 여건에 직면해 있다. 그러나 이러한 어려운 여건은 우리의 대응여하에 따라서는 우리나라가 선진산업사회로의 진입을 한걸음 앞당길 수 있는 좋은 기회를 제공할 수도 있다는 점을 인식할 필요가 있다.

최근 일본이 급격한 엔고 속에서도 정부와 기업의 공동 노력으로 이를 무난히 극복하고 산업의 국제경쟁력을 오히려 더욱 강화시킨 것은 우리에게 좋은 교훈을 던져주고 있다 하겠다.

더구나 전자부품 및 재료산업은 모든 산업의 기초산업적 특성을 가지고 있으며 2000년대의 정보화 사회를 지향하는데 선도적 역할을 담당한다는 점에서 앞으로 우리산업의 국제경쟁력을 키우기 위해서는 이 분야에 대한 정부의 체계적이고 효율적인 정책개발과 지원이 장기적인 관점에서 이루어져야 할 것이며 아울러 관련업계, 학계, 연구계 등에서도 정부의 정책방향에 맞추어 꾸준한 연구와 노력이 경주되어야 할 것이다.